

液晶基板乾燥機

<UDG- α F型>



2m/min以下の移動速度で移動する液晶基板を連続で完全乾燥します。厳密に制御された均一でシャープなCDA（露点温度 -80°C の超乾燥空気）を液晶基板表面に当て、1次・2次乾燥工程で基板表面およびパターン周辺部に残る微小水分を完全に乾燥させます。

UDG- α F型の特徴

■ 高速連続乾燥

移動速度2m/min以下の連続乾燥に対応しています。

■ 低ランニングコスト

超乾燥空気の原料はCDAを使用するため低コスト。UDG全体の消費電力も少ないのでランニングコストを低減できます。

■ 省設置面積

装置サイズが小さく、また熱を使用しないため冷却時間の必要がなく、製造ラインの省スペース化に寄与します。

■ 高コストパフォーマンス

高性能装置としては価格も低く、スペアパーツや保守部品点数も最小化。ユニット・リサイクル・システムにより、修理費用も極小化しています。

■ イージー・メンテナンス

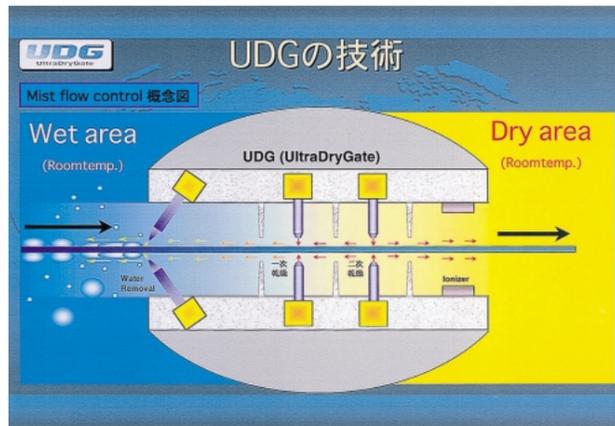
高信頼性を実現するために、各部をユニット化。万一の故障や定期点検時には、迅速かつ容易に作業が行なえます。

■ 安全

熱を使用しない乾燥方式なので、引火による火災等の危険性がない安全なシステムです。

■ UDG- α F型標準仕様

型式	α F37	α F160
Glassサイズ	370mm×470mm 対応	1600mm 幅対応の場合
Dimensions	約840mm×740mm×400mmH	最大1400mm×1740mm×400mmH
Glass移動速度	Max 2m/min	Max 2m/min
電力	200~230V, 1kW以下	200~230V, 1kW以下
CDA	全3.5Nm ³ /min(内 Dry area 1.5Nm ³ /min) 0.6Mpa(1次圧)	全10Nm ³ /min(内 Dry area 4.5Nm ³ /min) 0.6Mpa(1次圧)
排気	3.5Nm ³ /min見合う容量	10Nm ³ /min見合う容量
タクトタイム	40sec.	80sec.
その他	1.本仕様はUDG単体の仕様である。 2.洗浄装置等他装置に組み込んだ場合は搭載装置の仕様に従う。 3.詳細仕様は協議決定する。	



外観

プリント基板乾燥機

<UDG- β F型>



常温の超乾燥空気（露点温度Max -80°C ）を300m/secの高速で吹きつけることにより、プリント基板およびその表面に点在する無数の微小孔（スルーホール）内の水も瞬時に完全乾燥します。

UDG- β F型の特徴

■ UDG- β F型は、プリント基板の表面およびその表面に点在する無数のスルーホールを主に乾燥します。ノズルから300m/secのスピードで超乾燥空気を吹き付け、スルーホール内を瞬時に乾燥させます。

■ 露点温度が -80°C という超乾燥空気により常温乾燥を行い、基板を完全乾燥させます。

■ 水を分子レベルまで除去して製品に再結露させません。そのため、不完全乾燥による酸化シミが発生することがありません。

■ 絞りロールを使用しないため、絞りロールの汚れが製品に移りません。

■ 乾燥時間が速く、冷却時間の必要性がないことで、製造ラインの長さを短くできます。

■ 熱を伴わない乾燥法ですので安全性に優れています。

■ 実績基板条件

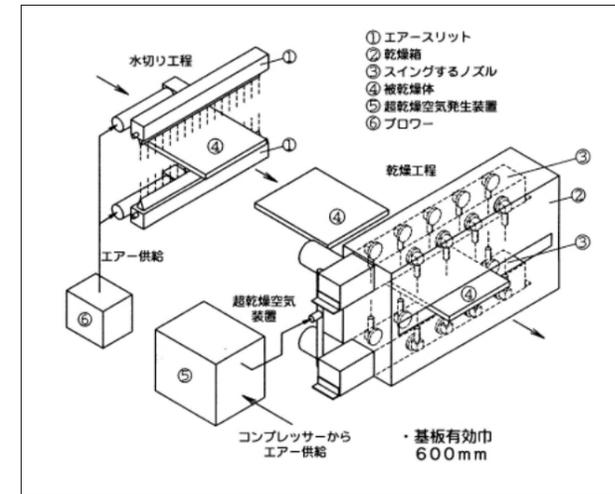
基板厚：0.06~8mm

スルーホール径： $\phi 0.2$ 以上

基板サイズ：50×50~1000×1000

■ UDG- β F型標準仕様

型式	β F64
ライン有効幅	700mm
ライン速度	Max 2.5m/min
ブロー空気量	4.4m ³ /min
静圧	9.81kPa
コンプレッサー空気量	0.49MPa・500NL/min
乾燥空気量	400NL/min
超乾燥空気露点温度	Max -80°C
最高使用温度	50 $^{\circ}\text{C}$
周囲使用温度	常温
タクトタイム	最小14sec.



フロー図



外観

※露点温度 -80°C とは=その空気を冷却してゆき -80°C になった時にはじめてその空気が結露する状態を示します。

※露点温度 -80°C とは=その空気を冷却してゆき -80°C になった時にはじめてその空気が結露する状態を示します。